

## アルミベース基板の実装

当社では自社の実装技術を生かし、アルミベース基板の実装を承っております。  
 基板設計、基板製作もあわせてご相談下さい。

### 効果

#### ■放熱

アルミと高熱伝導性絶縁層の構成にて放熱性に優れています。

#### ■高信頼性

デバイスの温度上昇を防ぎ、信頼性が向上します。

#### ■小型化

放熱効果が基板自体であるため、小型化できます。

#### ■組立工数の短縮

ヒートシンクへの組立がなくなり、加工時間が短縮できます。

#### ■シールド効果

アルミベースがシールドの役割になり耐ノイズ性に優れています。



### アプリケーション(代表例)

#### ■パワーモジュール

パワー MOSFET などの発熱量の大きいデバイスの放熱対策 —— インバータ、電源、ドライバー等に適しています。

#### ■LED モジュール

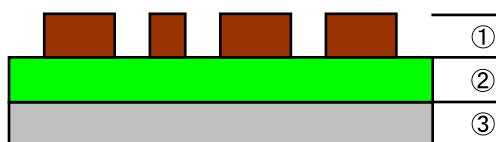
LED の放熱対策 —— 表示器、照明器具等

#### ■ご相談下さい

表面実装部品で放熱回路を製作したい場合 / 放熱回路をできるだけコンパクトにしたい場合  
 放熱回路の機構設計を簡易にしたい場合 / 大電流化したい場合

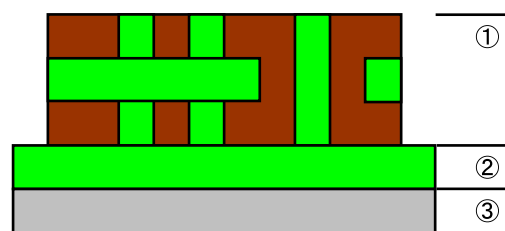
### 構造

#### アルミベース + 片面



- ① 銅箔 (35、70、105、140、200、300、500 μ)
- ② 絶縁層 (80、120、140、160、200 μ)
- ③ アルミベース (1.0、1.5、2.0、3.0mm)

#### アルミベース + 2層



- ① 2層基板
- ② 絶縁層
- ③ アルミベース

### 当社にお任せ下さい

回路設計、基板設計、部品調達  
 基板実装、ユニット組立、調整・検査

ISO9001 : 2008  
 ISO14001 : 2004

フェイス株式会社

〒252-0031 神奈川県相模原市南区大野台 4-1-61  
 TEL 042-759-4868 FAX 042-759-1809  
 URL <http://www.faith-ltd.co.jp>